

製品仕様書 PRODUCT SPECIFICATION	No.	IS-9852X	来歴 / REV.	1
	頁 / PAGE	1/5		
標 題 : 9852B/985*Sシリーズ 1.0mmピッチボードトボードコネクタ SUBJECT : SERIES 9852B/985*S 1.0mm pitch board to board connector	制定年月日 / ISSUE DATE	2011-6-9		
	改訂年月日 / REVISED DATA	2013-3-8		

1. 適用範囲 / Scope

本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製 9852B/985*S シリーズ 1.0mmピッチボードトボードコネクタに関する仕様及び性能上の必要事項について規定する。

This product specification is applied for IRISO ELECTRONICS CO.,LTD. series 9852B/985*S 1.0mm pitch board to board connector.

適合プラグ / Applied plug : IMSA-9852B-*(Z07~Z13)-*

適合ソケット / Applied socket : IMSA-9850S-****

IMSA-9852S-****

IMSA-9854S-****

IMSA-9856S-****

(適合ソケットは SMT PA9T 品のみ適用 / Applied socket is SMT PA9T product only.)

2. 形状、寸法及び材質 / Configurations dimensions and materials

構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。

See the product drawing attached.

3. 定格 / Rating

No.	項目 / Items	方法 / method	条件 / conditions	規格 / specifications
3-1	使用温度範囲 / Operating temperature limit	IEC : 603-1	-40~+105°C	/
3-2	定格電圧 / Voltage rating		125V (AC,DC)	
3-3	定格電流 / Amperage rating		1.0A	

4. 試験環境 / Environmental condition

No.	項目 / Items	方法 / method	条件 / conditions	規格 / specifications
4-1	環境条件 / Environmental qualification	JIS: C60068-1-5-3 (IEC : 60068-1)	常温 : 15~35°C 常湿 : 25~85%RH	/

5. 電気的特性 / Electrical performances

No.	項目 / Items	方法 / method	条件 / conditions	規格 / specifications
5-1	接触抵抗 / Contact resistance	IEC : 60512	短絡電流 / current:1mA 最大開放電圧 / voltage:20mV 周波数 / frequency:1kHz	初期値 : 50mΩ以下 Initial : 50mΩ or below
5-2	耐電圧 / Dielectric withstanding Voltage	IEC : 60512-4-1	AC250V ,60±5s	絶縁破壊等異常のない事。 Should not have any changes.
5-3	絶縁抵抗 / Insulation Resistance	IEC : 60512-3-1	DC250V ,60±5s	初期値 : 500MΩ以上 Initial : 500MΩ MIN.

6. 機械的特性 / Functional performance

No.	項目 / Items	方法 / method	条件 / conditions	規格 / specifications
6-1	コンタクトの保持力 / Contact retention force	IEC : 60512-16-20	25mm/min	4.9N 以上 4.9N or more.
6-2	ポストの保持力 / Post retention force	IEC : 60512-16-20	25mm/min.	4.9N 以上 4.9N or more.
6-3	結合力及び分離力 / Engaging and separating forces	IEC : 60512-13-1	25mm/min	初期値にて / Initial 挿入力 : 2.94N 以下 / 極 抜去力 : 0.2N 以上 / 極 Insertion force : 2.94N MAX./terminal Extraction force : 0.2N MIN./terminal

6. 機械的特性 / Functional performance

No.	項目 / Items	方法 / method	条件 / conditions	規格 / specifications
6-4	挿抜耐久性 (繰返し動作) / Insertion/extraction Endurance	JIS : C5402(6.3)	繰返し動作回数 / 30回 Operation frequency/30 times	80mΩ以下 80mΩ or below
6-5	振動試験 / Vibration test	IEC : C60068-2-6	振動周波数/Vibrational frequency: 10~55~10Hz 振幅 / amplitude : 1.5mm、 スイープ時間 / Sweep time : 1minute 方向 / Direction : X,Y,Z 2h	試験中 1 μs 以上の瞬断の ない事。 試験後 : 80mΩ以下 Discontinuity : 1 μs or below After the test : 80mΩ or below
6-6	衝撃試験 / Shock test	IEC : C60068-2-27	加速度 / Acceleration : 490m/s ² 作用時間 / Time : 11ms 方向 / Direction : X,Y,Z 回数 / 3回 : 3times	試験中 1 μs 以上の瞬断の 無い事。 試験後 : 80mΩ以下 Discontinuity : 1 μs or below After the test : 80mΩ or below
6-7	温度上昇試験 / Raise of Temperature test	IEC : 60512	温度安定後 1h 通電 / After the temperature stabilizes, energizing for one hour	温度上昇 : 30℃以下 Raise of temperature : 30℃ or below

7. 耐候性試験 / weatherability test

No.	項目 / Items	方法 / method	条件 / conditions	規格 / specifications
7-1	高温試験 / Dry heat	IEC : 60068-2-2	温度 / Temperature : 105±2℃ 時間 / Time : 96h	80mΩ以下 80mΩ or below
7-2	高温高湿試験 / Dump heat steady state	IEC : 68-2-3	湿度 / : 90~95% 温度 / Temperature : 60±2℃ 時間 / Time : 96h	80mΩ以下 80mΩ or below
7-3	塩水噴霧試験 / Salt mist	IEC : 68-2-11	水温 / Temperature : 35±2℃ 濃度 / Percentage humidity : 5±1% 時間 / Time : 48h	80mΩ以下 80mΩ or below
7-4	SO ₂ ガス試験 / SO ₂ gas test		温度 / Temperature : 40±2℃ 相対湿度 / Percentage humidity : 75% RH 濃度 / Cardinality : 10±3ppm 時間 / Time : 96h	80mΩ以下 80mΩ or below
7-5	H ₂ Sガス試験 / H ₂ S gas test		温度 / Temperature : 40±2℃ 相対湿度 / Percentage humidity : 75% RH 濃度 / Cardinality : 3±1ppm 時間 / Time : 96h	80mΩ以下 80mΩ or below
7-6	温度サイクル試験 / Change of temperature	IEC:60068-2-14 (JIS C0025)	温度 / Temperature : -55~+85℃ サイクル数 / Cycle : 10 cycle (1 サイクル / 1cycle : 1h)	80mΩ以下 80mΩ or below
7-7	温湿度変化試験 / Humidity Resistance (cycling)	JIS : C5402 (7.4)	温度 / Temperature : 上限/ Upper 80±2℃ : 下限/ Lower -20±3℃ 湿度 / Humidity : 90~95%RH サイクル数 / Cycle : 10 サイクル / 10cycle (1 サイクル / 1cycle : 8h)	80mΩ以下 80mΩ or below

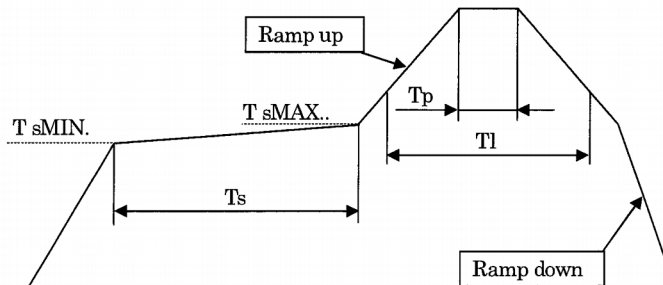
8. その他の特性 / Other Performance

No.	項目 / Items	方法 / method	条件 / conditions	規格 / specifications
8-1	はんだ付け試験法 (平衡法) / Solderability test (wetting balance method)	IEC : 68-2-20 IEC : 60068-2-58 IEC : 68-2-44 IEC : 68-2-54	温度 / Temperature : 245°C ± 5°C, 時間 / Time : 3 ± 0.5s	はんだ付着面積 / soldering area ≥ 95%
8-2	半田耐熱性 / Resistance to Soldering heat	JEDEC : J-STD-020C IEC : 68-2-20 IEC : 60068-2-58 IEC : 68-2-44 { JIS C60068-2-58-8.2.4 JIS C60068-2-58-8.1.2 }	①手半田/Plug manual soldering 半田温度 / Temperature : 350°C ± 5°C. 時間 / Time : 3s ± 0.5 s ②リフロー/Socket reflow-Soldering 温度 / Temperature : リフロー温度条件参照 / See temperature chart 時間 / Time : リフロー温度条件参照 / See temperature chart 回数 / Times : 2回 ・温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product. ・フラックスについては IRISO 選定品使用/ IRISO selection goods use of flux.	端子のガタ、割れ等異常のない事。 Should not have any flaw, scratch and crack.

8-2-②

・リフロー温度条件 / Reflow temperature

プロファイル条件 / Profile Feature	鉛フリーリフロー温度条件 / Sn-Pb Eutectic Assembly
・ Pre-heat T _{smin} . T _{smax} . time (T _{smin} . to T _{smax} .)	: 150°C MIN : 180°C MAX : 60-120s
T _l 温度 / temperature 時間 / time	: 230°C MIN. : 30~60s
T _p (ピーク / Peak) 温度 / temperature 時間 / time	: 260°C MAX. : 10s MAX



9. 外観 / Appearance

No.	項目 / Items	方法 / method	条件 / conditions	規格 / specifications
9-1	外観 / Appearance	IEC : 512-2		実使用上、問題無き事 Should not have any problems.

10. 製品の保管期間 Term of a guarantee

製造日より1年とする。
1 year from production day.

11. 保管条件 Storage condition

室内で温度-10~+40°C、湿度75%RH以下の相対湿度で保管して下さい。
Shall be storage in the house at -10~+40°C, 75%RH max.

△ 12. ウイスキーに関して About a whisker

本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウイスキーが発生する可能性があります。その為、ウイスキー発生に対する保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願いします。

This product utilizes lead-free tin plating. Any product with lead-free tin plating is susceptible to tin whisker. Iriso provides no assurances against the growth of tin whisker even under normal operating conditions. Customers assume all responsibility for any product failures due solely to the growth of tin whiskers.

△ 13. 和文と英文の差異について Difference between Japanese and English

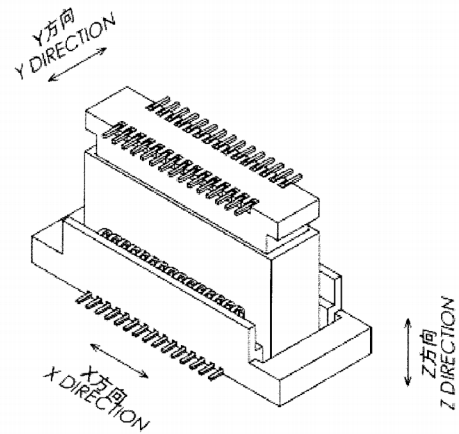
和文と英文の内容に差異が生じた場合には、和文の内容を優先致します。

When difference is found between Japanese Specifications and English Specifications, priority shall be given to Japanese.

△《取り扱い方法》 Handling method

1. 可動量 / Floating range

- ・本仕様書の適用プラグソケットの嵌合において、下記の可動量を保証する。
To guarantee the floating range of the following.
- ・右記のモデル形状は参考とします。(現物と異なる場合があります) /
It refers to the model shape of the reference of the right.
(It differs from a actual connector.)
- (1)X 方向可動量/X Direction : $\pm 0.8\text{mm}$
- (2)Y 方向可動量/Y Direction : $\pm 0.5\text{mm}$
- (3)Z 方向可動量/Z Direction : $+0.8\text{mm} / -0.5\text{mm}$



2. 使用上の注意 / Attention of using connector

- ・斜め嵌合やこじめる事の無い様にゆっくりと挿抜して下さい。
/When the connector is mating, shall not be twisted, and then mated it slowly.
- ・角度を付けた状態で押し込むとモールド端面どうしが強く擦れる事により、削りカスが発生します。
/The angled mating occurs shavings.
- ・位置決め後、モールド両端がゆるく嵌まった事を確認して真っ直ぐ押し込んで下さい。
/After positioning, please check that mold both ends have fitted in loosely, and push in straight.
- ・抜去時は真っ直ぐ抜いて下さい。コネクタの片側だけが持ち上がる様な回転抜去を行いますとモールドが破損する可能性があります。
/Please be pulled out straight. Pulling on one side, the mold is broken.
- ・下記のモデル形状は参考とします。(現物と異なる場合があります)
/It refers to the model shape of the reference of the following.
(It differs from a actual connector.)
- ・コネクタのみで基板の固定は行なわないで下さい。使用の際、コネクタの実装位置に近い位置で、必ず基板をビスにて確実に固定して下さい。コネクタに掛かる加速度は、セット組立品に於いても 43.12m/s^2 以下とする事。(共振振動が加わらない事。)
/It shall not be held the connector only, when you are assembled for the connector and P.C.B. When it shall be used the connector, the P.C.B. are held by the rivet certainty near mounting of the connector. Acceleration of connector : 43.12m/s^2 or less.
(The connector shall not be added to resonance acceleration.)
- ・誘い込み時の角度は図1～図2になりますので、記載角度以下で位置決めをして下さい。
/Figure 1 and 2 show guiding angle. Please locate it below the described angle.
(誘い込み時の角度とは最初の位置決め角度であり、嵌合可能な角度ではありません。)
/ (Guiding angle is initial location angle. It is not the angle to mate.)

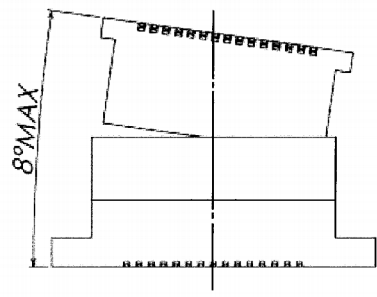


図1/ Fig.1

誘い込み時の角度
Guiding angle

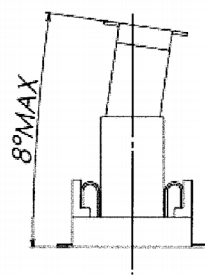


図2/ Fig.2

- ・嵌合時の許容角度は図3～図4になりますので、記載角度以下で使用して下さい。
/Please mate below the angle of the figure 3, 4.

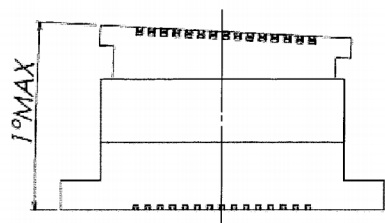


図3/ Fig.3

嵌合角度
Mating angle

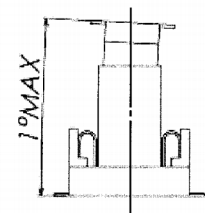


図4/ Fig.4